**ISSP2017商品パネル展示会**

**出展申し込み用紙**

|  |  |
| --- | --- |
| 会社名 | (日本語) (英語)  |
|
| 担当者住所・所属 | (日本語)〒\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(英語)  |
| 担当者名(日本語) (英語)　  | 担当者連絡先Tel 　 Fax　　E-mail  |
| 記入日  | 登録費（１単位） \120,000 |
|
| 申込単位数(１単位=１パネルと１テーブル)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 単位 |
| １００Ｖ－２Ａ電源（チェックして下さい）　　　□　要　　　　　　□　不要プロシーディングスへの無償広告掲載　　　□　希望する　　　□　不要貴社ホームページへのリンク　　　□　希望する　　　□　不要リンク先URL:　 （バナー用画像データも添付願います）自動スライドＣＭ　希望する　　　□　不要 |
|
| 合計  \ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 連絡事項 |

**申し込み期限** 2017年5月15日

**記入後この頁のみを下記宛てに電子メールでお送り下さい**

<申込先>

ISSP事務局

金沢工業大学 高度材料科学研究開発センター

〒924-0838

石川県白山市八束穂3-1

TEL076-274-9250　FAX076-274-9251

E-mail: exhibit@issp2017.jp